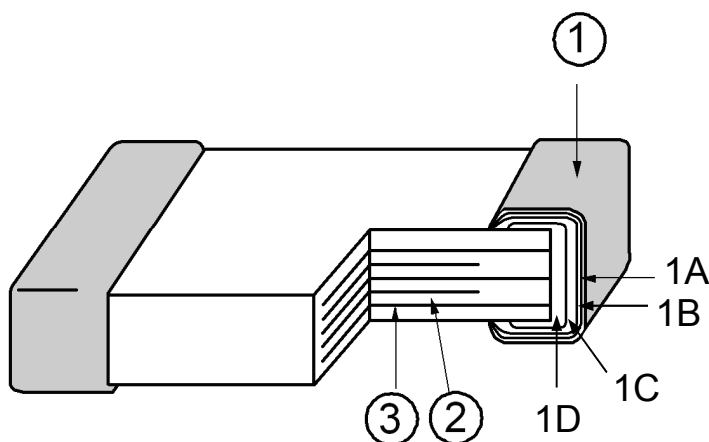


# チップ積層セラミックコンデンサ構造図および材料表 Structure and Material of Chip Multilayer Ceramic Capacitor

<GRJ/GCJ Series>

## 1. 内部構造/Example of Structure



## 2. 名称と材料名/Name and Material

| No. | 名称/Name                    | 主原料/Material              |
|-----|----------------------------|---------------------------|
| ①   | 外部電極<br>Termination        |                           |
|     | 1A<br>めっき層<br>Plated layer | すず<br>Tin                 |
|     | 1B<br>めっき層<br>Plated layer | ニッケル<br>Nickel            |
|     | 1C<br>下地電極<br>Electrode    | 導電性樹脂<br>Conductive Resin |
|     | 1D<br>下地電極<br>Electrode    | 銅<br>Copper               |
| ②   | 誘電体素子<br>Dielectric layer  | チタン酸バリウム系<br>Ceramic      |
| ③   | 内部電極<br>Inner electrode    | ニッケル<br>Nickel            |